

# 熔点138度LED无铅低温焊锡膏

产品名称	熔点138度LED无铅低温焊锡膏
公司名称	深圳市科达成金属有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科达成 型号:KDC-308Bi 加工定制:是
公司地址	深圳市宝安区新安办创业西路东南侧富源商贸大厦1栋B座1203（办公场所）
联系电话	0755-27592865 13480999211

## 产品详情

锡铋低温锡膏简介：

锡铋低温锡膏是无铅锡膏系列的一款。锡铋低温锡膏适合低温焊接，产品质量稳定而受到广大厂商的信赖和使用。锡铋低温锡膏的成分为sn42 pb58，适用于不耐高温材质的产品类如纸板、半纤维板等。锡铋低温锡膏属于松香型锡膏，在低温焊接上有很好的润湿能力。

锡铋低温锡膏的优点：

锡铋低温锡膏在银网上的操作时间长，有优良的连续印刷效果，在12小时以内粘度不会改变。锡铋低温锡膏有优良的焊接性能，有较宽的回流焊温度范围。在焊接作业时锡铋低温锡膏落锡点精确，流动性好。锡铋低温锡膏作业温度为140° -180°。

锡铋低温锡膏的测试结果：

低温锡膏snbi测试结果			
本表所列性能指标为参考值，实际值从每批交货的qa报告为准			
测试	结果	测试	结果

焊剂含量 (wt%)	10.5 ± 0.5	表面絕緣阻抗測試( )	>5 × 10 <sup>11</sup>	
卤素含量 (wt%)	<0.01	湿润性(级)	2	
粘度(25 時pa.s)	200 ± 10%	錫珠測試(级)	2	
水萃取阻抗( . cm)	>1 × 10 <sup>5</sup>			
鉻酸銀紙測試	合格			
銅板腐蝕測試	无			

锡铋低温锡膏的炉温说明：

预热区、保温区：用来将pcb的温度从周围环境温度提升到所需的活性温度。在保温阶段同时是低温锡膏充分润湿，去除氧化物。但升温斜率过大，到达平顶温度的时间过短，一是对零件的热冲击太大：二是使低温锡膏的水分、溶剂不能完全挥发出来，达到回流时，引起水分、溶剂沸腾，溅出锡球。建议：1-3 /秒  
 回流区：相容阶段作用是讲pcb装配的温度从活性温度提高到推荐的峰值温度，是低温锡膏与零件脚及pcb焊盘之间得到良好的共熔，峰值建议温度是180-190 。时间控制在50-90秒。冷却阶段：冷却速度控制在每秒1-4 下降，这样有利形成的细小的晶体。这样的焊点机械强度好。太快也会造成你焊点断裂。

使用方法：

( 开封前 )

开封前须将锡膏温度回升到使用环境温度上 ( 25 ± 2 ) ，回温时间约3-4小时，禁止使用。后须充分搅拌，搅拌时间为1-3分钟，视搅拌机机种而定。

( 开封后 )

(1)将锡膏约2/3的量添加于钢板上，尽量保持以不超过1罐的量于钢板上。

(2)视生产速度，以少量多次的添加方式补足钢板上的锡膏量，以维持锡膏的品质。

(3)隔天使用时应先行使用新开封的锡膏，并将前一天未使用完的锡膏与新锡膏以1：2的比例方式添加使用。

(4)锡膏印刷在基板后，建议于4-6小时内放置零件进入回焊炉完成着装。

(5)换线超过1小时以上，请于换线前将锡膏从钢板上刮起收入锡膏罐内封盖。

(6)锡膏连续印刷24小时后，由于空气粉尘等污染，为确保产品品质，请按照步骤4》的方法

(7)为确保印刷品质建议每4小时将钢板双面的开口以人工方式进行擦拭。

(8)室内温度请控制与22-28℃，湿度rh30-60%为最好的作业环境。

(9)欲擦拭印刷错误的基板，建议使用乙醇、ipa或去渍油。

保持期： 6个月 不可放置于阳光照射处.

锡铋低温锡膏规格：

科达成牌锡铋低温锡膏为瓶装产品，一瓶重量为500克，最低出货量为1瓶。锡铋低温锡膏应放在低温环境下储存。详细情况可咨询公司业务部或市场营销部。

科达成牌锡铋低温锡膏，是您最佳的选择！欢迎来电咨询和订货！

本产品的品牌是科达成，型号是KDC-308Bi，加工定制是是，粘度是200 (Pa · S)，颗粒度是25-45 (um)，合金组份是Sn42Bi58，活性是ym，类型是多种，清洗角度是免洗清，熔点是138度，规格是多种